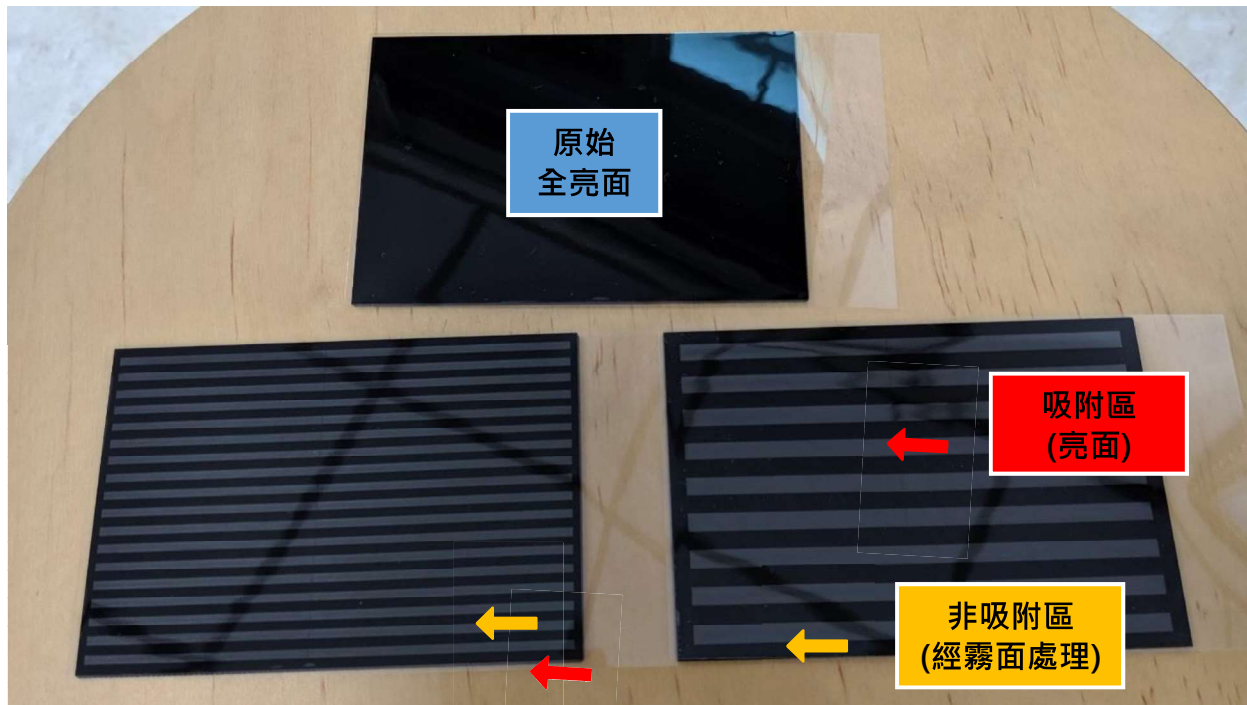


貼霸® 的設計與應用

程陽研發團隊將矽膠與高溫材料結合，開發出可重複黏貼的環保材料—「貼霸®」，利用真空吸附的原理，取代傳統貼膠帶方式，即可快速將 PCB 固定於治具上，提高生產良率、解決產線耗工問題，朝自動化生產邁進，透過以下案例希望能讓您更加地了解。

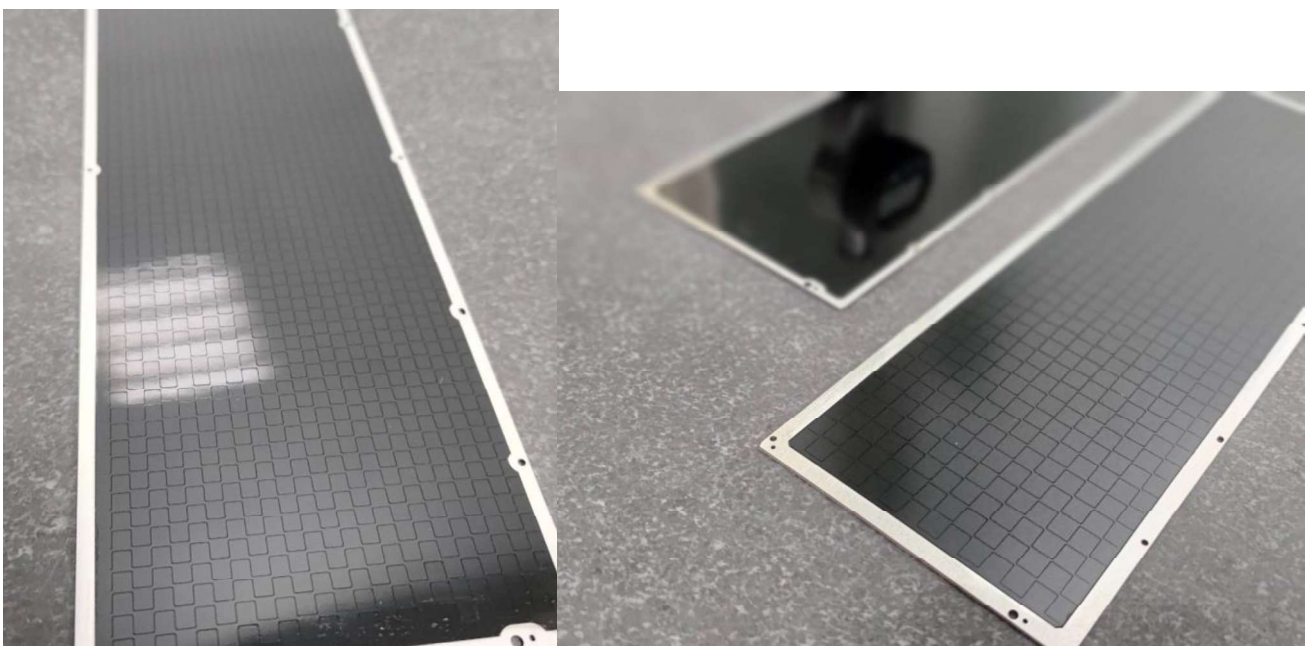
1. 表面工藝：

貼霸可以依照您各種不一樣的產品和製程進行客製化設計，未經設計的貼霸是沒有非吸附區功能的，因貼霸原材料是全亮面的。



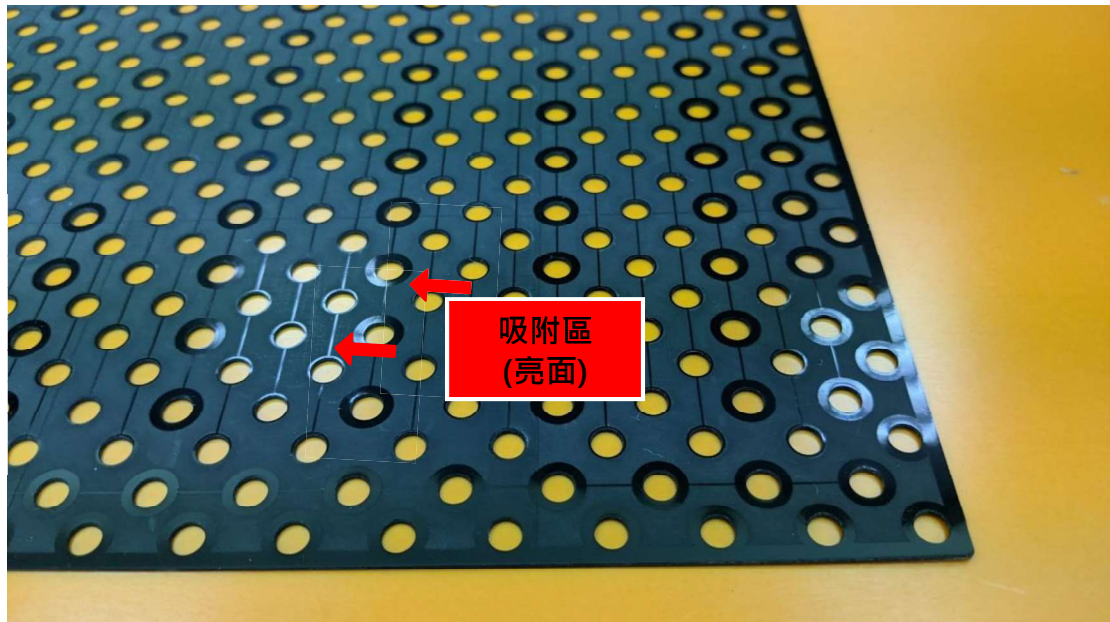
2. 蛇鱗紋貼霸載具：

利用蛇的鱗片特徵應用於貼霸，能調節在封裝製程上遇熱時所發生的膨脹現象，擁有平面真空吸附、平整度佳、耐高溫 260°C、高重複使用壽命、可耐模具壓力、經得起水洗、低粉塵...等多項優點，能吸附 0.1mm 以下薄型基板。

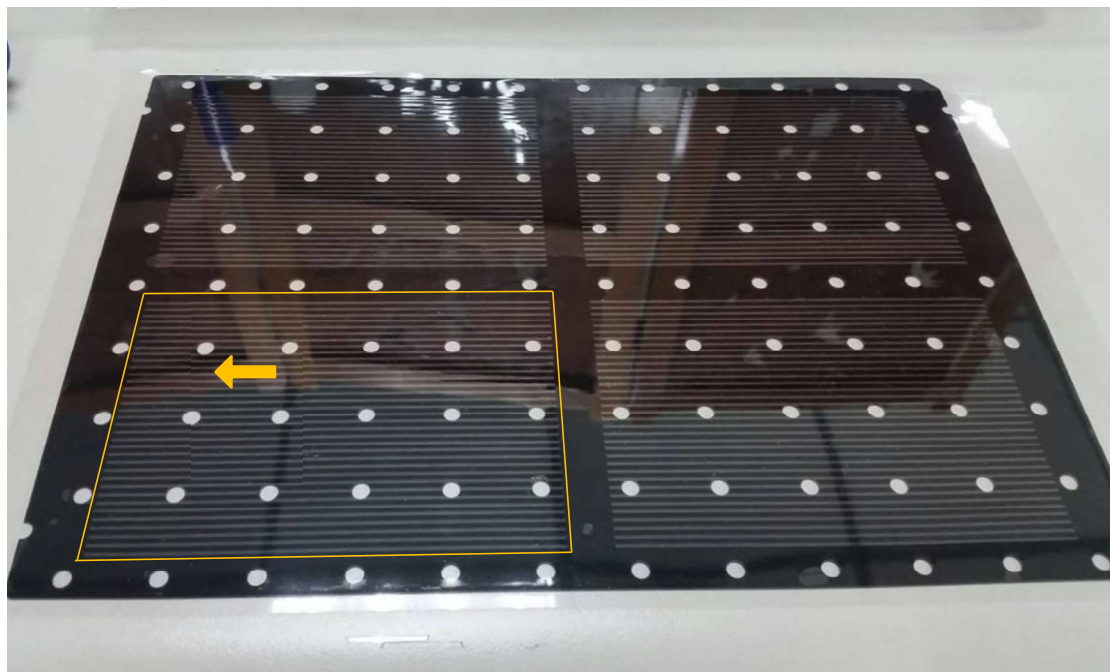


3. 貼霸的設計決定了吸附強度：

若是全以吸附亮面作使用，對您的產品而言強度過高的話，可能造成基板的變形或與基板分離時的損傷。



▲ 搭配使用手動/自動頂出機，設計調整每一個貼霸頂出孔的頂出力量。



▲ 非吸附功能以橫條紋設計，有效減少區域內 50% 吸附力。

貼霸®材質特性表

貼 霸®					
顏色	抗靜電黑 (T2)	黑 (T0)			
RoHS、PFOS 要求	符合®				
最高工作溫度	250°C、10~20 秒				
可提供厚度	0.5 +0.05/-0 mm	0.5 ± 0.1 mm			
可提供尺寸	410 x 360 mm	340 x 290 mm			
抗靜電值	10 ⁴ ~10 ⁷ Ω	10 ¹² Ω			
初始力 (鋼球編號)	7	8			
熱傳導性	0.6 w/mk				
抗化學腐蝕性	優				
使用次數	2,000 次以上 (依據不同的使用方法與環境，使用壽命也不同)				
酒精擦拭	不影響貼霸®黏度 (來回 50 次以上)				
頂出力量	貼霸® 頂出 PET 膜 (厚度 0.07mm) 所需力量，黑色為吸附區。				
	貼 霸® T0				
	A 寬度 (吸附區)	1.5 mm	2 mm	3 mm	4 mm
	六次平均力量(g)	35	50	65	95
	貼 霸® T2				
	A 寬度 (吸附區)	1.5mm	2mm	3mm	4mm
	六次平均力量(g)	25	35	50	60
	貼霸® 頂出玻璃 (厚度 1.1mm) 所需力量，黑色為吸附區。				
	貼 霸® T2				
	B 寬度 (吸附區)	4.7 mm	3 mm		
六次平均力量(g)	715	635			
					
結構圖層			保護膜 矽膠 石無鉛		